

智原科技公佈 2025 年第一季財務報告

第一季合併營收於先進封裝業務帶動下達新台幣 74.4 億，季增 152%，年增 188%，創單季歷史新高
上半年合併營收可望超越去年全年表現

2025 年第一季合併財務報表摘要

- 營業收入為新台幣 74.4 億元
 - 毛利率為 20.3%
 - 歸屬於母公司業主之淨利為新台幣 3.5 億元
 - 基本每股盈餘為新台幣 1.33 元
-

台灣·新竹 – 2025 年 4 月 22 日 – 智原科技 (TWSE: 3035)，ASIC 設計服務暨矽智財(IP)研發銷售領導廠商，今日公佈 2025 年第一季合併財務報表，合併營收為新台幣 74.4 億元，季增 152%，年增 188%，毛利率為 20.3%，歸屬於母公司業主之淨利為新台幣 3.5 億元，基本每股盈餘為新台幣 1.33 元。

回顧第一季，合併營收在先進封裝量產帶動下成長強勁，季增 152%，年增 188%，達新台幣 74.4 億元，不僅創下單季歷史新高，更大幅超越去年上半年合併營收。以產品別來看，量產及委託設計(NRE)收入較上季增加，IP 營收雖較上季減少但全年成長態勢不變。IP 本季營收季減 8%，年增 23%，為新台幣 4.0 億元，NRE 營收季增 38%，年減 28%，達新台幣 4.5 億元，量產營收則季增 201%，年增 306%，達新台幣 65.8 億，量產在先進封裝業務帶動下，較上季大幅增加，成長數倍以上，創下單季新高。第一季對智原來說是有許多項突破，除了營收跳躍式成長，季增 2.5 倍以上，先進製程及先進封裝的新接案數量更創下單季新高，同時，公司在封裝業務上又跨出一步，推出新「封測服務」以滿足異質封裝市場廣大需求。這項封測服務的價值鏈長且進入障礙高，需要完善的管理能力來統籌晶片設計、品質管理、先進封裝技術等多個面向，而強大的夥伴關係更是成功的關鍵。作為少數能提供完整封測技術服務的 ASIC 廠商，智原與晶圓廠、記憶體廠及封裝廠密切合作提供先進封裝一站式服務，尤其在 3D 封裝上，智原亦能協助客戶取得僅晶圓廠可提供的技術支援，大幅提高了公司的獨特性以及接案優勢。

展望第二季，NRE 營收在先進製程委託設計案認列下可望較上季增加並創下單季新高紀錄，今年上半年合併營收可望超越去年全年表現，整體營運規模將更上一層樓。展望未來，公司封裝業務百花齊放，客戶基礎持續擴大，除了扮演營收重要角色之一，亦可望為公司帶來更多 ASIC 及 IP 的衍生性商機。面對多變的外在環境，智原將秉持一貫的多元商務模式，對外積極拓展新業務及夥伴關係，對內在管理系統上保持高度應變能力，展現營運韌性，以達到變中求穩，為公司維持長期競爭優勢。

營運成果

營運成果

(金額: 百萬新台幣)	2025 年第一季	2024 年第四季	增(減) %	2024 年第一季	增(減) %
營業收入淨額	7,438	2,953	151.9	2,579	188.4
營業毛利	1,508	1,265	19.2	1,200	25.7
營業費用	(1,139)	(1,077)	5.8	(883)	29.0
營業利益	369	188	95.7	317	16.5
營業外收入及支出	86	107	-19.7	38	120.8
本期淨利(歸屬母公司業主)	346	236	46.6	280	23.5
基本每股盈餘 (元)	1.33	0.91		1.13	

財務報告

營業成本、營業費用與營業外收入及支出

(金額: 百萬新台幣)	2025 年第一季	2024 年第四季	增(減) %	2024 年第一季	增(減) %
營業收入淨額	7,438	2,953	151.9	2,579	188.4
營業成本	(5,930)	(1,688)	251.4	(1,379)	330.0
營業毛利	1,508	1,265	19.2	1,200	25.7
毛利率 (%)	20.3%	42.8%		46.5%	
營業費用	(1,139)	(1,077)	5.8	(883)	29.0
營業利益	369	188	95.7	317	16.5
營業利潤率 (%)	5.0%	6.4%		12.3%	
營業外收入及支出	86	107	-19.7	38	120.8

流動資產

(金額: 百萬新台幣)	2025.03.31	2024.12.31	2024.03.31
現金及約當現金	6,794	8,311	9,940
應收票據及帳款淨額	2,155	1,054	886
應收帳款週轉天數	20	43	43
存貨淨額	2,526	1,074	956
存貨週轉天數	28	69	71
流動資產合計	12,342	11,024	12,639

負債

(金額: 百萬新台幣)	2025.03.31	2024.12.31	2024.03.31
流動負債合計	4,963	3,872	3,507
應付票據及帳款	2,245	1,675	1,094
其他	2,718	2,197	2,413
非流動負債合計	817	985	694
負債總計	5,780	4,857	4,201
負債/權益比	42.2%	36.0%	30.1%

營收分析

委託設計營收（應用別）

應用	2025 年第一季	2024 年第四季	2024 年第一季
通訊網路	10.0%	7.1%	31.1%
行業用	30.9%	55.0%	39.5%
多媒體/消費性電子/ 電腦週邊	11.4%	0.9%	3.5%
HPC & AI	24.3%	12.6%	13.6%
IoT	23.4%	24.4%	12.3%

委託設計營收（製程技術別）

技術	2025 年第一季	2024 年第四季	2024 年第一季
≥0.25um	4.1%	2.0%	-
0.11um~0.18um	3.1%	11.7%	5.5%
55nm~90nm	11.2%	4.6%	6.8%
40nm	21.5%	26.2%	19.4%
28nm	31.2%	28.0%	36.9%
≤14nm	28.9%	27.5%	31.4%

量產營收（應用別）

應用	2025 年第一季	2024 年第四季	2024 年第一季
通訊網路	1.5%	2.5%	4.4%
行業用	5.7%	18.4%	38.1%
多媒體/消費性電子/ 電腦週邊	3.3%	6.9%	10.0%
HPC & AI	78.1%	36.3%	0.5%
IoT	11.4%	35.9%	47.0%

量產營收（製程技術別）

技術	2025 年第一季	2024 年第四季	2024 年第一季
≥0.25um	0.3%	0.4%	0.3%
0.11um~0.18um	2.3%	4.4%	27.0%
55nm~90nm	11.0%	35.4%	46.5%
40nm	7.2%	19.9%	15.6%
28nm	1.2%	3.8%	10.6%
≤14nm	78.0%	36.1%	-

總營收（產品別）

產品	2025 年第一季	2024 年第四季	2024 年第一季
量產	88.5%	74.0%	62.9%
委託設計服務	6.1%	11.1%	24.3%
矽智財	5.4%	14.9%	12.8%

Contact

曾雯如
財務長兼發言人
+886-3-5787888

盧昭儀
投資人關係
+886-3-5787888 ext. 84588
ir@faraday-tech.com

關於智原

智原科技（Faraday Technology Corporation, TWSE: 3035）以提供造福人類、支持永續發展的晶片為使命，持續發展完整的 ASIC 解決方案，包含 2.5D/3D 先進封裝、Arm Neoverse CSS 設計、FPGA-Go-ASIC 與晶片實體設計服務。同時，智原擁有豐富的矽智財資料庫，涵蓋 I/O、Cell Library、Memory Compiler、ARM-compliant CPUs、LPDDR4/4X、DDR4/3、MIPI D-PHY、V-by-One、USB 3.1/2.0、10/100/Giga Ethernet、SATA3/2、PCIe Gen4/3、可程式設計高速 SerDes，及 PCIe Gen4/3 等數百個週邊訊號 IP。更多資訊，請瀏覽智原科技網站：www.faraday-tech.com 或 [LinkedIn](#) 專頁。